**联络人**
投资人关系
+886 3397 5999 ext. 1204
ir@winfoundry.com

# 稳懋半导体公告 2020 年第一季自结财务报告

2020 年 04 月 29 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(29)日公告 2020 年第一季自结财务报告。

## 2020 年第一季财务概况

- 本季合并营收新台币 60.71 亿元，较前季减少 12%，较去年同期增加 68%
- 本季合并毛利率为 43.0%，较前季减少 1.2 个百分点；本季营业净利率 31.9%，较前季减少 1.8 个百分点
- 本季营业净利为新台币 19.38 亿元，较前季减少 17%，较去年同期增加 546%
- 本季税后净利为新台币 15.75 亿元，较前季减少 14%，较去年同期增加 945%；每股盈余为新台币 3.76 元，前季为新台币 4.40 元

## 2020 年第二季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- 预计第二季营收较前一季下滑 low-single digit 百分比。
- 预计第二季毛利率约为 low-forties 的水平。

---

**免责声明**
本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。

## 管理者评论

***“虽然全球第一季已开始笼罩在新冠肺炎的疫情阴影当中，但稳懋无论营收及获利都有优于往年同期的表现，2020年第一季营收达到新台币60.71亿元，吻合我们先前的预期，较前一季下滑12%，与前一年同期相比大幅成长68%，虽然产能利用率下滑但仍能维持高档，在产品组合变化不大之下，营业毛利率为43%，第一季净利及每股盈余分别来到新台币15.75亿元及3.76元的水平。***

***综观第一季整体营收，当产品组合中所有应用皆因为季节性因素同步下滑时，我们发现稳懋第一季晶圆出货与5G连结性较高的Cellular 及 Infra表现相对较佳，而5G Cellular 占整体Cellular 营收仍有20%以上的水平，我们相信这代表着全球无线通信往5G发展的趋势不变，也同时象征着稳懋在5G技术的研发及业务拓展正处于领先的地位。虽然全球持续受新冠肺炎的影响，对于经济及供应链的影响暂时难以估计，但是稳懋除了加强防疫及供应链管理之外，同时与客户之间的研发进度及产能扩充皆未中断，为后续的任何风险与机会做好准备。***

***展望2020年第二季，我们预计营收将较上一季下滑low-single digit百分比，预计毛利率约为low-forties 的水平。"***

---

## 关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于 1999 年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英吋晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术：异质接面双极性晶体管(HBT)和应变式异质接面高迁移率晶体管(pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及 3D 感测领域中，稳懋更以 MMIC 生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。